

9月市场洞察报告

半导体市场分析与趋势展望

洞察行情 精准决策

“DISTINCTIVE
INSIGHTS,
INFORMED
DECISION-MAKING”

序言

本报告由安芯易电子商务（深圳）有限公司推出，旨在为客户、供应商及合作伙伴提供半导体行业资讯及市场趋势预测，报告涵盖宏观动态、半导体产业动态、终端市场动态、重点产品行情、市场重点趋势等模块，助力行情洞察、精准决策。

本报告每月更新，可关注安芯易电子订阅号，及时获取报告发布等信息。您可以通过联系安芯易客户经理或通过 marketing@360ic.com 获取完整版报告。

目录

摘要.....	1
一、宏观动态.....	2
(一) 经济景气跟踪.....	2
(二) 行业需求动态.....	3
(三) 资本市场动态.....	5
(四) 产业政策动态.....	7
(一) 短期影响.....	9
(二) 中期影响.....	10
(三) 长期影响.....	11
三、终端市场动态.....	13
(一) 人工智能.....	13
(二) 新能源.....	14
(三) 汽车.....	15
四、重点产品行情.....	17
(一) 存储芯片：2024 年 Q4DRAM 存储器价格涨幅放缓.....	17
(二) MLCC：ODM 备料放缓，预估 Q4MLCC 出货量季减 3.6%	19
(三) MCU：交期趋向稳定.....	19
(四) 模拟芯片：2024 年 Q3 出现需求回暖与价格微升.....	20
五、市场重点趋势.....	21
信息来源.....	22
免责声明.....	23

摘要

2024 年 9 月重点行情趋势	
宏观趋势	● 9 月中国 PMI 景气度恢复上升，全球制造业恢复状况略有下降 ● 全球半导体销售额持续增长；费城半导体指数回暖 ● 加拿大就对中国电池、半导体、太阳能等产品潜在加征关税措施启动意见征询；美国加针对中国锂电池、电动汽车等加征关税，禁用中国智能网联汽车软硬件，后续或限制中国 DRAM 产品；欧盟决议征收中国电动车反补贴关税
产业动态	● AMD 发布全新 AI 芯片、服务器 CPU、AI 网卡、DPU 和 AI PC 移动处理器；英伟达 Blackwell AI GPU 预计 Q4 产量达 45 万片；铠侠因市场波动取消 10 月 IPO 计划，寻求更佳上市时机 ● 三星坚持不剥离代工业务，力图通过重组和投资提升竞争力；SK 海力士全球首次量产 12 层 HBM3E 芯片，引领 AI 存储器市场 ● 台积电和三星计划在阿联酋投资超 1000 亿美元建设芯片项目，面临多重挑战
终端市场	● AI：联想集团在印度启动 AI 服务器生产；亚马逊未来 10 年在巴西投资 18 亿美元扩大数据中心业务 ● 新能源：亿纬锂能近期签订重大储能电池供应协议，产能扩张加速；比亚迪在巴基斯坦卡拉奇建立电动车生产基地 ● 汽车：比亚迪德国战略布局，收购 Hedin 旗下德国市场汽车分销网络；特斯拉发布革命性 Robotaxi；自动驾驶技术公司 Mobileye 决定终止激光雷达研发
产品行情	● 存储芯片：2024 年 Q4DRAM 存储器价格涨幅放缓 ● MCU：9 月交期基本稳定 ● MLCC：ODM 备料放缓，预估 Q4MLCC 出货量季减 3.6% ● 模拟芯片：2024 年 Q3 出现需求回暖与价格微升

一、宏观动态

(一) 经济景气跟踪

● 9 月中国制造业 PMI 景气度恢复上升，全球制造业恢复状况略有下降

9 月份，中国制造业生产活动加快，PMI 升至 49.8%，比上月上升 0.7 个百分点。从 2024 年的中国整体情况来看，制造业 PMI 经历 5 个月下跌后首次回升，需重点持续关注制造业景气度回升。各规模企业 PMI 均有回升。大型企业 PMI 为 50.6%，较上月提升；中、小型企业 PMI 分别为 49.2%和 48.5%，其中小型企业生产指数 5 月份以来首次升至临界点以上。高技术制造业和装备制造业继续领跑。从重点行业看，高技术制造业和装备制造业 PMI 分别为 53.0%和 52.0%，比上月上升 1.3 个百分点和 0.8 个百分点，继续保持良好发展态势。但需要重视的是，PMI 指数仍处荣枯线之下，反映需求不足的企业占比仍超过 60%，采购量指数、进口指数等仍有下降，表明需求不足的问题仍然突出，企业生产经营活动恢复趋势尚不稳定。

9 月全球制造业 PMI 回落 0.8pp 至 48.8，连续 3 个月低于荣枯线。显示全球制造业恢复状况较上月整体恢复力度仍待提升。

全球各地区制造业 PMI

时间	全球	中国	日本	韩国	印度	美国	欧元区
2023-09	49.10	50.20	48.50	49.90	57.50	49.00	43.40
2023-10	48.80	49.50	48.70	49.80	55.50	46.70	43.10
2023-11	49.30	49.40	48.30	50.00	56.00	46.70	44.20
2023-12	49.00	49.00	47.90	49.90	54.90	47.40	44.40
2024-01	50.00	49.20	48.00	51.20	56.50	49.10	46.60
2024-02	50.30	49.10	47.20	50.70	56.90	47.80	46.50
2024-03	50.60	50.80	48.20	49.80	59.10	50.30	46.10
2024-04	50.30	50.40	49.60	49.40	58.80	49.20	45.70
2024-05	50.90	49.50	50.40	51.60	57.50	48.70	47.30
2024-06	49.50	49.50	50.00	52.00	58.30	51.70	45.60
2024-07	49.80	49.40	49.10	51.40	58.10	46.80	45.80
2024-08	48.90	49.10	49.80	51.90	57.50	47.20	45.60
2024-09	48.80	49.80	49.70	48.30	56.50	47.20	45.00

数据来源：FastBull

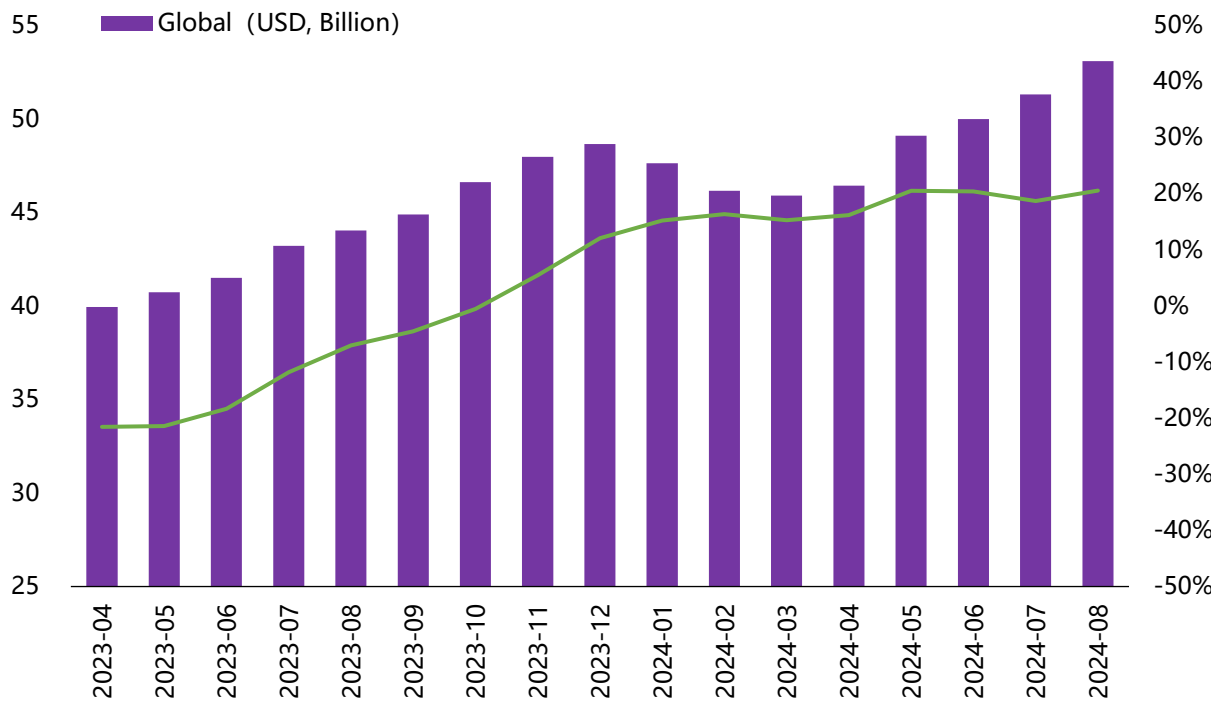
(二) 行业需求动态

● 8 月全球半导体销售额同比增长 20.6%

2024 年 8 月，半导体销售额继续呈上升趋势，再次创下了最高销售额记录。半导体市场同比增长率创下了 2022 年 4 月以来的最大增幅。月度销售额连续第五个月增长。

与此同时，中国芯片出口同比大增 24.8%。据海关公布数据显示，今年前 8 个月，我国集成电路出口 7360.4 亿元，增长 24.8%；集成电路出口已经超过汽车（同期汽车出口金额为 5408.4 亿元），成为中国出口产品的重大品类。

全球半导体销售额（十亿美元）



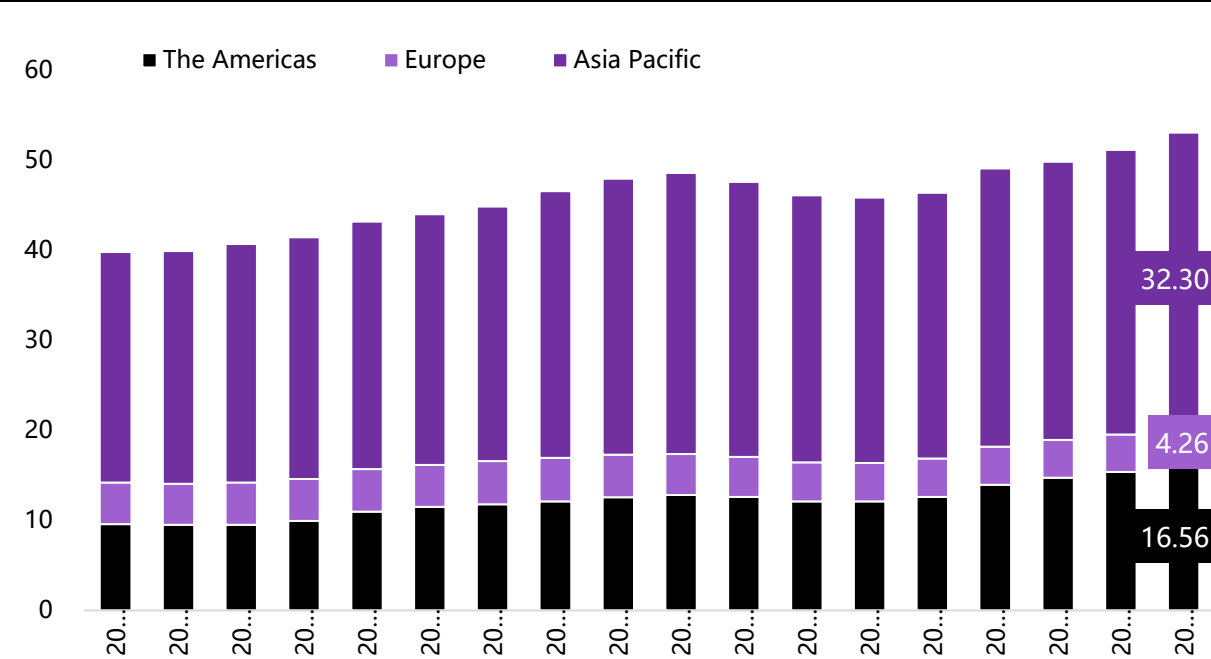
数据来源：SIA

分地区来看，其中美洲市场的增长尤为显著，同比增长高达 43.9%。

中国大陆地区的半导体市场也表现出色，同比增长 19.2%，持续引领全球半导体市场的复苏。中国半导体行业在全球复苏的背景下表现尤为亮眼，已成为全球半导体市场的主要推动力之一。

在全球范围内，半导体市场的增长不仅受到技术创新和市场需求回升的推动，还受到各国政府对半导体产业支持政策的影响。特别是在中国，半导体产业的国产替代和自主可控成为了重要的发展战略，这进一步加速了国内半导体产业的发展。随着全球半导体产业的持续投资和创新，预计这一增长趋势将会持续。。

分地区半导体销售额（十亿美元）



数据来源：SIA

(三) 资本市场动态

● 10 年期美债收益率快速上行，降息预期谨慎

9 月下旬以来，十年期美国国债收益率从议息会议后的 3.75% 左右水平快速上行至 4.0% 以上，收益率曲线继续陡峭化。

月美联储大幅降息 50 个基点后，美国初次申请失业金人数连续低于预期，9 月非农就业人数 25.8 万人大超预期，非制造业 PMI 数据也超市场预期。美国劳工部在 10 月 10 日这天晚上公布数据，9 月美国 CPI 同比上涨 2.4%，核心 CPI 同比上涨 3.3%。这些都显示美国经济仍有韧性，此前衰退定价过于激进。截止 10 月 10 日美国联邦基金利率期货显示 2025 年降息预期已从此前 120 个基点回落至 90 个基点，长债利率回升显示市场正在重新校准对美国的经济预期。建议后续密切关注美国经济情况走势，可能会影响跨国贸易资金成本等。

美国 10 年期国债利率(%)



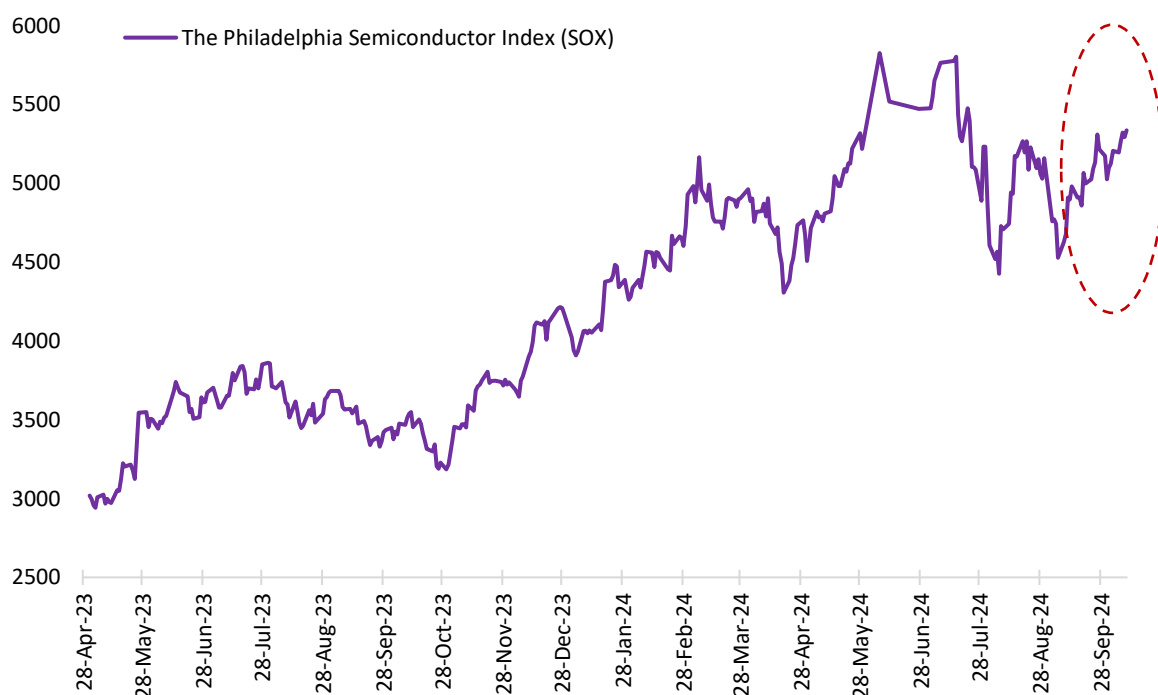
数据来源: Investing

● 9 月费城半导体指数小幅上涨

2024 年 9 月费城半导体指数表现强于纳斯达克 100，月内微升 0.28%。2024 年 9 月费城半导体指数上涨 0.28%，9 月纳斯达克 100 下跌 1.65%，年初至今费城半导体指数上涨 19.22%。

2024 年 9 月美股半导体板块上涨公司数少于下跌公司数，9 月费城半导体指数 30 只成分股中上涨 9 只，下跌 21 只。涨跌幅前五的公司分别为 COHERENT (+14.06%)、莱迪思半导体(+12.06%)、AMD (+10.45%)、美光科技 (+7.76%)、英特尔 (+6.44%)；涨跌幅后五的公司分别为格芯(-13.77%)、QORVO(-10.86%)、SKYWORKS (-9.87%)、阿斯麦 (-7.81%)、艾马克技术 (-6.77%)。

费城半导体指数 (SOX)



数据来源: MacroMicro

(四) 产业政策动态

- 加拿大就对中国电池、半导体、太阳能等产品潜在加征关税措施启动意见征询

加拿大政府 9 月 10 日宣布，就对**电池和电池部件、半导体、太阳能产品和关键矿物等领域**的中国产品潜在加征新关税开启为期 30 天的意见征询，利益相关方可在 10 月 10 日前就潜在措施提供反馈意见。

此前，加拿大已经宣布对自华进口的电动汽车、钢铝产品采取加征关税等限制措施，并已启动意见征询。对此，中国商务部发言人表示强烈不满和坚决反对，并计划将加拿大的相关做法提交至世界贸易组织争端解决机制。中国还将根据《中华人民共和国对外贸易法》的相关规定，对加拿大的相关限制措施发起“反歧视调查”，并可能采取相应措施。

此外，中国商务部已宣布对原产于加拿大的进口油菜籽进行反倾销立案调查，并可能对加拿大相关化工产品发起反倾销调查。这些措施是对加拿大政府采取的歧视性单边限制措施的回应，旨在捍卫中国企业的正当权益。

- 美国加针对中国锂电池、电动汽车等加征关税

美国政府确实宣布了对中国电动汽车加征 100%关税，以及对车用锂离子电池加征 25%关税的政策。这一政策已于 2024 年 9 月 27 日开始实施。此外，美国还计划在 2026 年对非电动汽车用锂离子电池加征 25%的关税。这些措施是在之前宣布的四年期复审结果基础上进一步提高关税税率，并拟扩大加征关税的产品范围。对于中国企业来说，这无疑增加了出口到美国的成本和难度。但根据数据显示，中国电动汽车的出口市场并不完全依赖于美国。2023 年，中国汽车总出口量是 522 万辆，其中电动汽车占比 34%，约为 177 万辆。这些电动车主要出口到了欧洲、东南亚、中东、南亚、拉美等地区，以及澳大利亚和俄罗斯等国家。因此，尽管美国的关税政策会对中国电动汽车出口造成一定影响，但中国车企在全球市场上仍然具有竞争力。

- 美国拟对华 DRAM 芯片制造商实施制裁以限制高带宽存储器技术发展

据外媒消息表示，美国政府可能对部分中国领先的 DRAM 芯片制造商实施制裁，这是华盛顿为阻碍中国科技雄心所采取的最新举措，目标直指在高带宽存储器(HBM)半导体领域有显著影响力的中国企业，包括 CXMT、武汉新芯和 SwaySure。这些企业与华为等已经受到美国限制的公司有联系。

美国计划允许美国对外国制造的产品实施管制，只要这些产品使用了哪怕极小部分的美国技术。这可能意味着，如果其他国家或地区的芯片制造商使用了美国的技术，哪怕是在海外制造的产品，也不能向中国出口。

这些潜在的制裁措施可能会对中国 DRAM 芯片制造商产生重大影响，因为它们可能会限制中国获取关键的半导体生产技术和设备，从而影响中国在全球半导体产业中的竞争力。

● 美国拟禁用中国智能网联汽车软硬件

美国商务部近期提出了一项新规定，计划禁止美国境内智能网联汽车和自动驾驶汽车使用来自中国的关键硬件和软件，这一提议主要基于所谓的“国家安全”考量。据报道，这项提议将适用于所有在公共道路上行驶的轮式车辆，包括汽车、卡车和公交车，但不会影响在私人道路上行驶的农用车或矿用车。针对中国智能网联汽车软件、硬件的禁令将分别于 2027 车型年、2030 车型年生效，对于没有车型年的汽车，禁令将于 2029 年 1 月 1 日生效。

该提议还可能对那些希望进入美国市场的中国汽车制造商产生重大影响，包括比亚迪、蔚来科技、文远知行等企业。这些公司可能需要寻找新的市场或调整其全球战略以适应这一变化。

● 欧盟决议征收中国电动车反补贴关税，中欧将继续谈判

盟成员国代表在 10 月 4 日投票通过了欧盟委员会提交的对中国电动汽车反补贴案终裁草案，拟对原产于中国的电动汽车征收最终反补贴税。这意味着中国电动汽车制造商进入欧洲市场将面临最高 45% 的超高关税，具体来说，特斯拉被加征 7.8%，比亚迪被加征 17%，吉利被加征 18.8%，上汽集团被加征 35.3%。这一决策可能会对中国电动汽车出口到欧盟造成一定的影响。短期内，这可能会削弱中国电动汽车在欧洲市场的竞争力，影响中国车企在该地区的销售。

欧盟计划于 10 月 30 日公布最终调查结果及实施条例。在最后期限到来之前，中国与欧盟就价格承诺的谈判仍在继续。。

二、半导体产业动态

半导体产业动态概览			
维度	厂商	经营动态	解读
短期影响	AMD (超威半导体)	AMD 发布全新 AI 芯片、服务器 CPU、AI 网卡、DPU 和 AI PC 移动处理器	AI 芯片竞争格局出现新变化
	Nvidia (英伟达)	英伟达 Blackwell AI GPU 预计 Q4 产量达 45 万片，有望带来超 100 亿美元收入	高端 AI 芯片热度不减
	KIOXIA (铠侠)	铠侠因市场波动取消 10 月 IPO 计划，寻求更佳上市时机	存储芯片市场行情动荡
中期影响	Samsung (三星电子)	三星坚持不剥离代工业务，力图通过重组和投资提升竞争力	三星代工业务拖累业绩
	SK hynix (海力士)	SK 海力士全球首次量产 12 层 HBM3E 芯片，引领 AI 存储器市场	持续关注 HBM 发展
长期影响	Samsung/TSM (三星/台积电)	台积电和三星计划在阿联酋投资超 1000 亿美元建设芯片项目，面临多重挑战	中美科技竞赛，中东起海外地区崛起
	Samsung (三星电子)	三星拟缩减 1z DRAM 产线	高端存储芯片持续挤压产能
	ST/Qualcomm 意法半导体/高通	意法半导体与高通达成无线物联网战略合作，推动边缘 AI 和物联网创新	AI 联动物联网新领域

(一) 短期影响

● AMD 发布全新 AI 芯片、服务器 CPU、AI 网卡、DPU 和 AI PC 移动处理器

AI 芯片 **AMD Instinct MI325X GPU 首次启用 HBM3E 高带宽内存**，AI 峰值算力达到 21PFLOPS，并与去年发布的、同样采用 HBM3E 的英伟达 H200 GPU 用数据相比：**内存容量是 H200 的 1.8 倍，内存带宽、FP16 和 FP8 峰值理论算力都是 H200 的 1.3 倍。**

AMD 还披露了最新的 AI 芯片路线图，采用 CDNA 4 架构的 MI350 系列明年上市，其中 MI355X 的 AI 峰值算力达到 74PFLOPS，MI400 系列将采用更先进的 CDNA 架构。更高的数据中心算力，离不开先进的网络解决方案。对此，AMD 发布了业界首款支持 UEC 超以太网联盟的 AI 网卡 Pensando Pollara 400 和性能翻倍提升的 Pensando Salina 400 DPU。另一款重磅新品是第五代 EPYC 服务器 CPU，被 AMD 称为“面向云计算、企业级和 AI 的全球最好 CPU”，采用台积电 3/4nm 制程工艺，最多支持 192 核、384 个线程。其中顶配 EPYC 9965

默认热设计功耗 500W，以 1000 颗起订的单价为 14813 美元（约合人民币 10 万元）。

- **英伟达 Blackwell AI GPU 预计 Q4 产量达 45 万片，有望收入超 100 亿美元**

英伟达预计在 2024 年第四季度生产约 45 万片基于 Blackwell 架构的 AI GPU。尽管初期遇到了设计问题导致产量较低，但摩根士丹利的分析师认为，英伟达已经解决了这些问题，并预计公司将按计划进行生产。Blackwell GPU 的需求强劲，预计如果顺利销售，可能为英伟达带来超过 100 亿美元的收入。英伟达的 Blackwell 系列 GPU 因其在 AI 计算性能上的突破而受到市场的高度期待，这些 GPU 将支持训练和部署大规模 AI 模型，满足当前对高性能 AI 硬件的强烈需求。此外，英伟达的管理层表示，他们对 Blackwell 的收入预期充满信心，并预计在 2025 年将获得更多人工智能处理器市场份额。

- **铠侠因市场波动取消 10 月 IPO 计划，寻求更佳上市时机**

铠侠是全球第三大 NAND 闪存芯片制造商，原本计划在 10 月进行首次公开募股 (IPO)，但由于市场环境的变化，特别是其上市同行股票的大幅下跌，使得原本 1.5 万亿日元 (约 103.9 亿美元) 的市值目标变得难以实现。铠侠的股东之一，贝恩资本 (Bain Capital)，原本希望通过 IPO 来筹集资金，以应对公司面临的财务挑战，包括连续的年度亏损和即将到期的债务。

铠侠在经历了一段时间的财务困境后，最近一个季度的财务报告显示公司已恢复盈利。然而，由于全球经济的不确定性，包括通货膨胀、对经济衰退的担忧、俄乌冲突以及供应链受到疫情影响等因素，铠侠决定推迟其 IPO 计划，以等待一个更合适的市场时机。

(二) 中期影响

- **三星坚持不剥离代工业务，力图通过重组和投资提升竞争力**

尽管去年晶圆代工和系统 LSI 业务遭受了 3.18 万亿韩圆 (约合 24 亿美元) 的巨额亏损，三星电子仍然表明了其对这些业务的长期承诺。公司董事长李在镕在接受路透社采访时明确表示，三星没有剥离代工芯片和逻辑芯片设计部门的计划，而是致力于发展这些业务。三星公司计划在年底前启动重组 DS (半导体代工) 部门计划，从而打破部门壁垒。该公司未来计划裁员高达 30%，其代工业务正面临多重困境，包括 3nm GAA 工艺的低良率问题。虽然剥离代工业务可能提高客户信任，但独立的代工部门在没有三星盈利的存储芯片业务的财务支持下，可能

难以维持长期生存。因此，三星选择保留代工业务，以期通过内部协同和财务支持，提升代工业务的竞争力。三星电子一直在努力减少对存储芯片生产的依赖，加大对代工和系统 LSI 业务的投资。公司曾为苹果 iPhone 生产应用处理器，但在 2019 年失去了这项业务。三星甚至制定了到 2030 年超越台积电，成为领先合同芯片制造商的雄心勃勃的计划。为此，公司已在韩国和美国投入数十亿美元新建晶圆厂。

- **SK 海力士全球首次量产 12 层 HBM3E 芯片，引领 AI 存储器市场**

SK 海力士宣布，其已开始全球率先量产 12 层 HBM3E 芯片，实现了现有 HBM 产品中最大的 36GB 容量。这款新产品的运行速度提高至现有内存的最高速度 9.6Gbps，能在搭载四个 HBM 的单个 GPU 运行大型语言模型时，每秒读取 35 次 700 亿个整体参数。为了实现与现有 8 层产品相同的厚度同时提升 50% 的容量，SK 海力士将单个 DRAM 芯片制造得比以往薄 40%，并采用硅通孔技术（TSV）垂直堆叠。此外，SK 海力士还应用了其核心技术先进 MR-MUF 工艺，提升了 10% 的散热性能，并增强了控制翘曲问题，确保了产品的稳定性和可靠性。

（三）长期影响

- **台积电和三星计划在阿联酋投资超 1000 亿美元建设芯片项目，面临多重挑战**

台积电和三星电子，作为全球领先的芯片制造商，正在考虑在阿联酋投资建设大规模的芯片制造业务，这一项目的潜在价值可能超过 1000 亿美元。根据媒体报道，两家公司的高管已经访问了阿联酋，讨论了在当地建设大型芯片制造工厂的可能性。阿联酋方面表现出了强烈的意愿和资金实力来支持这一项目，特别是阿布扎比的主权发展机构穆巴达拉（Mubadala）可能成为主要资金支持者。

这个投资项目不仅反映了阿联酋在科技领域的雄心，也是对全球芯片产能扩展需求的响应。项目的目标是增加全球芯片产量，降低芯片价格，同时确保芯片制造商的利润不受影响。然而，该项目还面临诸多挑战，包括技术难题、水资源短缺、工程人才缺乏以及政治因素等。

值得注意的是，美国对这一项目表示了关注，尤其是对先进人工智能芯片可能通过阿联酋流向中国市场的风险。因此，台积电和三星正在与美国政府进行初步协商，讨论如何让美国监督来自阿联酋工厂的芯片生产和运输问题。

- **三星拟缩减 1z DRAM 产线**

韩国业内人士近日透露，三星电子计划在今年年底前制定对其平泽 P2 工厂 DRAM 生产线进行尖端 DRAM 转换的投资计划。

三星电子平泽 P2 工厂自 2020 年下半年以来开始运营，其中 DRAM 产线主要生产 1z DRAM（第三代 10 纳米级 DRAM），目前其产量已大幅减少。因此，三星电子开始准备将 P2 1z DRAM 转换为 1b 或更尖端 DRAM 的生产基地。

其中，1b DRAM 是最新一代商用 DRAM，三星电子已完成了 1b DRAM 的内部质量测试，并已开始建设量产 1b DRAM 的设施。考虑到除了 P2、P3 以及华城 15 和 16 线之外，三星还在对 1b DRAM 进行改造投资，预计到明年初三星电子 1b DRAM 产能将达每月 10 万片。

此外，三星电子还计划投资“下一代 DRAM”。消息称，P2 工厂将部分 1z DRAM 转换为 1b DRAM 制程，剩余部分则转换为 1c（第 6 代）或 1d（第 7 代）DRAM。据业界人士透露，P2 转换投资的生产线配置设计预计将在今年第四季度完成，相关设施的订单将于明年下达。

- **意法半导体与高通达成无线物联网战略合作，推动边缘 AI 和物联网创新**

意法半导体与高通宣布达成新的战略协议，共同开发基于边缘 AI 的下一代工业和消费物联网解决方案。此次合作将整合高通先进的无线连接技术与意法半导体的微控制器生态系统，推出内置高通技术的 Wi-Fi/蓝牙/Thread 多协议 SoC 产品组合的独立模块，可与任何 STM32 通用微控制器产品进行系统级集成。首批产品预计将于 2025 年第一季度向 OEM 厂商供货，随后将扩大供货范围。未来，双方还计划推出更多 Wi-Fi/蓝牙/Thread 组合 SoC 产品，并逐步扩展到工业物联网的蜂窝连接领域，这一合作将为物联网应用开发带来新体验，为开发者和终端用户提供无缝集成的开发便捷性和优异的无线连接性能。

三、终端市场动态

终端市场动态概览			
维度	厂商	经营动态	解读
人工智能	Lenovo (联想)	联想集团在印度启动 AI 服务器生产，目标年产 5 万台	AI 技术蓬勃发展
	APPLE (苹果)	塔塔电子 iPhone 零部件工厂突发火灾	Iphone16 供应链或受影响
	AWS (亚马逊)	亚马逊未来 10 年在巴西投资 18 亿美元扩大数据中心业务	数据中心供应链持续受益
新能源	AESI (亿纬锂能)	亿纬锂能近期签订重大储能电池供应协议，产能扩张加速	储能行业“金九银十”带动行情
	BYD 比亚迪	比亚迪在巴基斯坦卡拉奇建立电动车生产基地，部署快速充电站	持续看好中国新能源企业出海
汽车	Mobileye	自动驾驶技术公司 Mobileye 决定终止激光雷达研发	激光雷达逐步被计算机视觉感知技术取代
	BYD 比亚迪	比亚迪德国战略布局：收购 Hedin 旗下德国市场汽车分销网络	受限中美关系，中国新能源车企进展海外布局加速
	TESLA (特斯拉)	特斯拉发布革命性 Robotaxi，预示自动驾驶新时代到来	持续看好无人驾驶领域

(一) 人工智能

● 联想集团在印度启动 AI 服务器生产，目标年产 5 万台

联想集团计划在印度南部工厂生产 AI 服务器，目标年产 5 万台，以及 2400 台 GPU 服务器，专为机器学习等资源密集型任务设计。这些产品将满足本地需求并出口至亚太地区。联想还将在班加罗尔设立 AI 服务器研发实验室，以支持全球研发网络。公司承诺在印度进行长期投资，通过新实验室展示其开发尖端技术的决心。班加罗尔研发中心将参与产品从设计到测试的全生命周期，推动联想在全球 AI 技术领域的领导地位。

- **塔塔电子 iPhone 零部件工厂突发火灾**

塔塔电子位于印度南部的一家生产苹果 iPhone 零部件的重要工厂发生大火，导致至少 10 人接受医疗救治，其中 2 人住院。

火灾发生在泰米尔纳德邦霍苏尔市的一家工厂，该工厂生产部分 iPhone 零部件。火灾发生在塔塔综合大楼内的另一栋建筑附近，该建筑将在未来几个月生产完整的 iPhone。最高地区行政官员 K.M. Sarayu 表示，火灾被控制在一栋建筑内，并已完全扑灭。她表示，尚未决定何时恢复生产。

- **亚马逊未来 10 年在巴西投资 18 亿美元扩大数据中心业务**

亚马逊网络服务 (AWS) 宣布了一项重大投资计划，即在未来十年内将在巴西投资约 18 亿美元 (101 亿雷亚尔) 以扩大其在该国的数据中心业务。这笔资金将用于数据中心的扩展、建造、连接、运营和维护。这一决策体现了亚马逊对拉丁美洲市场的重视，以及对云计算和人工智能领域未来发展的承诺。通过这项投资，AWS 将能够提升其在巴西以及整个拉丁美洲地区的服务质量和响应速度，满足不断增长的云服务需求，并为该地区的数字化转型提供强有力的支持。

(二) 新能源

- **亿纬锂能近期签订重大储能电池供应协议，产能扩张加速**

亿纬锂能近期确实有重大的电池供应合作进展。根据公告，亿纬锂能的子公司亿纬动力与美国储能解决方案供应商 American Energy Storage Innovations, Inc. 签订了供货协议。这份协议是对之前亿纬锂能与 American Battery Solutions 签订的协议的转让和扩展。**原先，亿纬锂能预计向 ABS 供应 13.389GWh 的方形磷酸铁锂电池，而新的协议将这一供应量增加至约 19.5GWh。**

这一合作不仅体现了市场对亿纬锂能储能电池产品性能和供货能力的认可，也有助于亿纬锂能与 AESI 建立长期稳定的合作关系，进一步巩固和提升亿纬锂能在储能市场的影响力和综合竞争力。**此外，亿纬锂能还计划在未来几年内大幅提升其储能电池的出货量，预计到 2025 年，其动力电池和储能电池的合计出货量将不低于 101GWh。这表明亿纬锂能正在积极扩大其在全球储能市场中的份额，并对其产品的未来需求持乐观态度。**

- **比亚迪在巴基斯坦卡拉奇建立电动车生产基地，部署充电站**

比亚迪宣布计划在巴基斯坦卡拉奇新建电动车生产基地，预计新工厂将于 2026 年启动运营。比亚迪与当地企业 Mega Motors 建立了合作伙伴关系，共同推进在巴基斯坦部署快速充电站，为该国电动车的推广普及做好基础设施支撑。比亚迪在巴基斯坦的这一战略布局，不仅体现了其对巴基斯坦市场的长期承诺，也彰显了其在全球新能源汽车技术领域的领导地位。比亚迪计划在卡拉奇建设的汽车组装厂，将是巴基斯坦首家新能源汽车组装厂，用来生产“最先进的”新能源汽车。此外，比亚迪还计划在巴基斯坦的主要城市及高速公路沿线安装电动汽车充电桩，以支持新能源汽车的发展。这将大大改善巴基斯坦的充电基础设施条件，为新能源汽车的普及提供有力保障。

(三) 汽车

- **自动驾驶技术公司 Mobileye 决定终止激光雷达研发**

9 月 9 日，自动驾驶技术公司 Mobileye 发布公告称，已决定终止用于驾驶辅助和完全自动驾驶系统的下一代调频连续波 (FMCW) 激光雷达的内部开发。主要是因为公司在 EyeQ6 计算机视觉感知技术上取得了显著进展，内部成像雷达性能提升，以及第三方 ToF 激光雷达的成本效益超出预期。此外，市场需求的不确定性和公司当前面临的财务压力也是决策的重要因素。Mobileye 强调，这一变化不会影响现有客户产品计划，公司将继续开发内部成像雷达技术。

Mobileye 计划在今年年底关闭激光雷达研发部门。虽然关闭激光雷达研发部门预计不会对 Mobileye 2024 年的业绩产生实质性影响，但将避免未来的激光雷达开发支出。不过 Mobileye 澄清称，这一决定不会影响任何现有的客户产品计划或产品开发，且该公司仍将致力于其内部成像雷达的开发，其成像雷达正在按计划满足性能规格，并将如期在明年投入生产。

虽然 Mobileye 强调这一决定与英特尔或任何外部公司无关，但考虑到英特尔近期的财务状况和战略调整，这可能间接影响了 Mobileye 的决策。

- **比亚迪德国战略布局：收购 Hedin 旗下德国市场汽车分销网络**

比亚迪已经宣布将收购其在德国的分销商 Hedin Electric Mobility，这一举措将使比亚迪能够直接管理其在德国市场的销售活动，包括在斯图加特和法兰克福的门店。这次收购将有助于比亚迪在欧洲市场提高其定价和供应能力，预计将在 2024 年第四季度完成。

此次交易还涵盖了斯图加特和法兰克福两处关键销售门店的运营管理权，标志着比亚迪在德国的销售策略将迎来重大转变。

- **特斯拉发布革命性 Robotaxi，预示自动驾驶新时代到来**

特斯拉在最新的发布会上展示了其无人驾驶出租车（Robotaxi）原型“CyberCab”，这标志着特斯拉在自动驾驶领域迈出了重要一步。CyberCab 设计独特，取消了传统方向盘和踏板，内部仅依靠中控屏幕进行操作，预计成本低于 3 万美元，并计划于 2026 年量产。特斯拉 CEO 马斯克宣布，已有近 50 辆 CyberCab 具备小批量生产能力。此外，特斯拉还展示了“RoboVan”，同样取消方向盘和踏板，能提供高载客能力。特斯拉的“完全自动驾驶”（FSD）系统正在不断更新，目前超过 40 万辆车正在测试该系统。马斯克预计，借助规模经济和实地学习，FSD 将加速完善并最终实现完全自动化。尽管面临技术和监管挑战，特斯拉的 Robotaxi 项目预示着未来出行方式的重大变革，可能引发共享出行领域的新竞争并改变汽车产业规则。

四、重点产品行情

（一）存储芯片：2024 年 Q4 DRAM 存储器价格涨幅放缓

2024 年 Q3 之前，消费型产品的终端需求持续疲软，而 AI 服务器成为支撑存储器需求的主要力量。HBM 技术的发展正在挤压现有的 DRAM 产品产能，供应商对合约价格的上涨保持坚持。然而，由于消费型产品的终端需求持续疲软，智能手机品牌持观望态度，以及 PC OEM 在传统销售旺季的业绩未达预期，**预计第四季度存储器价格的涨幅将大幅放缓。一般型 DRAM 的涨幅预计在 0%至 5%之间，整体 DRAM 平均价格预计上涨 8%至 13%，较前一季度的涨幅有所收敛。**

在 PC DRAM 领域，消费者持观望态度，导致 PC OEM 在传统销售旺季的业绩未达预期。因此，预计第四季度 PC DRAM 均价将终止上涨，与前三季度大致持平。**服务器 DRAM 价格预计季度增长 0%至 5%，其中 DDR5 Server DRAM 合约价可能维持 3%至 8%的涨幅，而 DDR4 价格调整受限。**

在移动 DRAM 市场，由于供应商扩增产能，LPDDR4X 市场出现供过于求，预计第四季度合约价将季减 5%至 10%。LPDDR5X 价格则因库存相对健康且供应量未显著增长，预计价格将大致持平。图形 DRAM 需求依旧平淡，价格预计与 Q3 持平。Consumer DRAM 市场需求疲软，预计 Q4 价格将季减 0%至 5%，DDR4 价格虽是主流产品，但产出持续增加，存在下跌可能性。

需求端方面，除了 HBM 供应商 SK 海力士、美光、三星获利率有明显回升之外，**其他 PC/消费电子产品存储公司，近期营收不如预期，甚至都处于亏损状态或亏损边缘。存储芯片厂商将很多库存转给下游模组厂，多家存储模组厂今年二季度平均库存水平较高，已达到 7-8 个月、甚至 9-11 个月水平。**

产品类型	3Q24 价格变动	4Q24E 价格预测
PC DRAM	DDR4: 上涨 8~13% DDR5: 上涨 8~13%	DDR4: 基本持平 DDR5: 基本持平
Server DRAM	DDR4: 上涨 8~13% DDR5: 上涨 13~18%	DDR4: 基本持平 DDR5: 上涨 3~8%
Mobile DRAM	基本持平	LPDDR4X: 下降 5~10% LPDDR5X: 基本持平
Graphics DRAM	上涨 3~8%	基本持平
Consumer DRAM	DDR3: 基本持平 DDR4: 上涨 3~8% 传统 DRAM:	DDR3: 下降 0~5% DDR4: 基本持平
Total DRAM	上涨 8~13% HBM 混合: 上涨 10~15% (HBM 渗透率: 6%)	传统 DRAM: 上涨 0~5% HBM 混合: 上涨 8~13% (HBM 渗透率:7%)

数据来源：Trendforce

(二) MLCC：ODM 备料放缓，预估 Q4MLCC 出货量季减 3.6%

由于美国市场通胀降温 and 联准会降息，以及国际形势的不确定性可能导致消费者减少支出，预计 2024 年 Q4MLCC 供应商的出货总量将减少 3.6%，约 12,050 亿颗。ODM 对第四季度的笔电预报订单量平均下滑 5%至 8%，品牌方对手机、笔电等订单规划持保守态度，导致备料态度谨慎。尽管 AI 服务器需求稳健，NVIDIA 的 Blackwell GPU 推迟量产，但 Hopper 架构的需求增长，带动了相关产品订单的增加。同时，美元走弱和亚洲货币上涨给 MLCC 供应商带来运营和定价压力，供应商计划控制产能稼动率和库存水平以稳定产品定价。日、韩供应商的平均产能稼动率维持在八成以上，而其他厂商则在六到七成之间。由于下半年旺季开局不如预期，供应商在运营和定价方面的态度变得更加谨慎。

(三) MCU：交期趋向稳定

汽车需求下降，工业客户订单未明显改善，但 AI 服务器、智能消费电子的需求提升带来结构性的高增长；价格有所下行。

各厂商 MCU 交期情况

厂商	产品系列	交期 (周)	交期趋势
ST (意法半导体)	主流 MCU (STM32F0、L 系列)	10-24	交期延长
NXP (恩智浦)	32 位 MCU	13-39	交期稳定
	通用类 MCU (LPC17x)	12-50	基本稳定
	汽车 MCU (MP5x、FS32x、MCFx)	18-52	交期稳定
MICROCHIP (微芯)	8 位 MCU (PIC16x、ATMEGA25x)	4-12	交期稳定
	32 位 MCU (PIC16x、AT89x、 ATMEGA25x)	4-18	交期稳定
	32 位 MCU (ATSAMA5x、PIC32x)	4-20	交期稳定

信息来源：富昌电子、网络公开资料整理、Wind

(四) 模拟芯片：2024 年 Q3 出现需求回暖与价格微升

2024 年第三季度，模拟芯片市场呈现复苏迹象，需求有所回升，特别是在智能手机、人工智能、物联网和汽车电子等领域。尽管模拟电源和信号链器件的销量预计呈下降趋势，但整体市场需求在消费电子复苏和新兴领域增长的带动下有所改善。

价格方面，模拟芯片价格整体呈小幅上涨态势，显示出市场在价格上的稳定性。交货周期继续缩短，显示出供应链的改善。头部模拟芯片公司的库存周转情况在第二季度有所下降，表明去库存取得了一定成果。尽管市场竞争激烈，但随着需求回暖，模拟芯片公司的业绩开始恢复。

展望未来，亚太地区预计将成为模拟芯片市场增长的主要动力，而国产模拟芯片公司则需要从消费级产品向工规级、车规级产品转型，以获取更大的市场空间和更稳定的经营利润。

全球及中国模拟芯片下游应用占比		
应用领域	全球占比	中国占比
消费电子	10%	30%
通信	25%	14%
计算机	6%	7%
工业	15%	15%
汽车电子	25%	25%
其他	5%	9%

资料来源：Statista

五、市场重点趋势

- **各国对于中国企业出海限制持续，受影响范围持续扩大**

2024 年 9 月，在近期的国际贸易环境中，中国高科技产品如电池、半导体、太阳能等面临多方面的挑战。加拿大政府宣布对这些领域的中国产品进行为期 30 天的关税意见征询，可能增加中国产品进入加拿大市场的难度。与此同时，美国对中国电动汽车和锂电池加征高额关税，并计划对华 DRAM 芯片制造商实施制裁，限制中国在半导体领域的竞争力。

此外，美国商务部提议禁止使用中国智能网联汽车软硬件，进一步限制中国企业进入美国市场。欧盟也通过了对中国电动汽车征收反补贴税的草案，这可能会削弱中国电动汽车在欧洲市场的竞争力。

这些贸易壁垒和挑战对中国企业来说意味着出口成本的增加和市场准入的困难，同时也促使中国企业寻找新的市场机会和调整全球战略以适应这些变化。。

- **存储芯片热度稍减，下半年面临挑战；MLCC 出货减少；模拟芯片行情微升**

Q4 存储器市场增长放缓，智能手机和 PC 需求疲软，而 AI 服务器需求稳健。MLCC 出货量预计减少 3.6%，供应商面临美元走弱和亚币转强带来的压力。模拟芯片市场在 Q3 出现需求回暖和价格微升，尤其在智能手机、AI、物联网和汽车电子领域。亚太地区将成为模拟芯片市场增长的主要动力。

信息来源

- [1] Tech: Japan's Biggest IPO in 6 Years, Kioxia, Is Off. Here Is the Likely Reason, 2024
- [2] Metal Industries R&D Center CEO Visits Taiwan AI Labs FedGPT Drives Innovation in Smart Medical Devices and Metal Industry Upgrades,, 2024
- [3] The Critical Effort to Combat Illicit Chip Diversion, SIA, 2024
- [4] 2024 State of the Industry Report Underscores Opportunities and Challenges for U.S. Chip Industry, SIA, 2024
- [5] Intel' s Foundry Spin-off Could Improve Chances of Securing Orders from Tech Giants such as Apple and AMD, TrendForce, 2024
- [6] AMD Unveils its Latest AI Accelerators MI325X and MI355X, with TSMC Emerges as the Major Beneficiary, TrendForce, 2024
- [7] Major Breakthroughs in China' s Storage and Silicon Photonics Chip Technologies, SIA, 2024
- [8] 买方优先去库存, 2024 年第四季度 DRAM 存储器价格涨幅放缓, Trendforce, 2024
- [9] Intel' s Lunar Lake Processors Arriving Q3 2024, Intel, 2024
- [10]Global AI Server Demand Surge Expected to Drive 2024 Market Value to US\$187 Billion; Represents 65% of Server Market, Says TrendForce, 2024
- [11]U.S. economy remains solid, on path to 'soft landing' with no meaningful layoffs, CNBC, 2024
- [12]Europe' s economy survived 'terrible prophecies' but must now tackle trade with China: EU' s Gentiloni,CNBC, 2024
- [13]Infineon provides a broad range of products for Xiaomi' s new SU7 smart electric vehicle, Infineon, 2024
- [14]Microsoft offers cloud customers AMD alternative to Nvidia AI processors, Reuters, 2024
- [15]AI Server and AI Notebook Hardware Upgrades Drive Demand for High-Capacitance MLCCs, Boosting Average Supplier Prices, Says TrendForce, 2024
- [16]Google invests 1 billion euros in Finnish data centre to drive AI growth, Reuters, 2024
- [17]Microsoft to invest 4 billion euros in France, Reuters, 2024
- [18]半导体行业月度深度跟踪：国内外公司中报表现分化，关注下半年景气度持续性和新品浪潮, 招商电子, 2024
- [19]Amazon to Invest \$9 Billion in Singapore Cloud Infrastructure, Wall Street Journal, 2024
- [20]季增 14.2%，第二季度 NAND Flash 营收达 167.96 亿美元,3Trendforce, 2024
- [21]Eku Energy announces first battery storage project in Japan, Eku Energy, 2024

免责声明

安芯易电子商务（深圳）有限公司(下称“安芯易公司”)所发布的月度报告由安芯易公司市场部基于现已公开的资料、信息、研究报告等进行整理编制而成。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映安芯易公司在报告发布当期的判断、观点，仅供学习参考之用，不构成对所述产品的出价、征价、要约或要约邀请，不构成任何合同或承诺的基础，不构成买卖任何投资工具或者达成任何交易的推荐，亦不构成任何投资、采购及其他应用建议和指导，对任何因直接或间接使用本报告涉及的信息和内容或者据此进行交易、投资所造成的一切后果或损失，安芯易公司不承担任何法律责任。因此，读者在阅读本报告时应保持警惕，并进行独立的判断和分析。

安芯易公司对本报告中所引用的资料、研究报告所涉及的或从第三方媒体获得的信息及数据的真实性、准确性、完整性和及时性不作任何明示或默示的保证。所发布的信息、观点以及数据有可能因发布日之后的情势或其他因素的变更而不再准确或失效，但安芯易公司不承担更新不准确或过时的信息、观点以及数据的义务，在对相关信息进行变更或更新时亦不会另行通知。

该报告版权归安芯易公司及相关内容提供方所有，未经授权，任何人不得以任何方式转载、修改、翻版、分发、复制、发表。

安芯易电子商务（深圳）有限公司

2024 年 9 月



安芯易隶属于Ample Solutions集团,成立于2008年,在全球拥有8个办公室,专注于为全球电子制造业客户提供元器件全球采购及供应链服务。我们始终秉持“专注、专业、坚韧、谦卑”的核心价值观,为客户提供卓越服务,助力客户成功。

我们拥有100+资深采购专家,并与来自全球的10000+供应商建立合作,致力于以更快的速度,更低的成本,为客户解决元器件供应链问题。

在深圳和香港,我们建立了两个高标准品质控制中心,严格遵循国际品质控制体系。从供应商管理到品质检测,全方位地防范风险,确保客户的元器件供应链安全和稳定。

